



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号： PCN#20110822001
2011 年 8 月 26 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HVAL-SLL LM258x/LM358x/LM2904 製品 チップ一部改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	<input checked="" type="checkbox"/> Design/Specification	<input checked="" type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	HVAL-SLL LM258x/LM358x/LM2904製品 チップ一部改定 現行 : チップレビジョン Rev E 変更後 : チップレビジョン Rev H			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	12月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画		<input type="checkbox"/> 終了	
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し		<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容 : 弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) LM258x/LM358x/LM2904製品について、供給能力確保の為に、チップレビジョンを現行 Rev E からRev H にチップを一部改定します。データシート規格値の変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
チップレビジョン	Revision E	Revision H

理由 : 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
LM258AD	LM258DRG4	LM2904PSRE4	LM358APE4	LM358PE4
LM258ADE4	LM258P	LM2904PSRG4	LM358APW	LM358PS
LM258ADG4	LM258PE4	LM2904PW	LM358APWE4	LM358PSE4
LM258ADGKR	LM2904D	LM2904PWE4	LM358APWG4	LM358PSG4
LM258ADGKRG4	LM2904DE4	LM2904PWG4	LM358APWR	LM358PSR
LM258ADR	LM2904DG4	LM2904PWR	LM358APWRE4	LM358PSRE4
LM258ADRE4	LM2904DGKR	LM2904PWRE4	LM358APWRG4	LM358PSRG4
LM258ADRG4	LM2904DGKRG4	LM2904PWG3	LM358D	LM358PW
LM258AP	LM2904DR	LM2904PWG4	LM358DE4	LM358PWE4
LM258APE4	LM2904DRE4	LM358AD	LM358DG4	LM358PWG4
LM258D	LM2904DRG3	LM358ADE4	LM358DGKR	LM358PWR
LM258DE4	LM2904DRG4	LM358ADG4	LM358DGKRG4	LM358PWRE4
LM258DG4	LM2904P	LM358ADGKR	LM358DR	LM358PWG3
LM258DGKR	LM2904PE4	LM358ADGKRG4	LM358DRE4	LM358PWG4
LM258DGKRG4	LM2904PS	LM358ADR	LM358DRG3	
LM258DR	LM2904PSE4	LM358ADRE4	LM358DRG4	
LM258DRE4	LM2904PSG4	LM358ADRG4	LM358P	
LM258DRG3	LM2904PSR	LM358AP	LM358PE3	

製品表示

この変更に伴い、チップレビジョン、出荷ラベル記載のチップレビジョンが下記のように変更されます。

チップレビジョン (2P)	
現行	E
変更後	H



図1 出荷ラベル記載箇所の例

信頼性試験

信頼性試験計画			
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qualification Device:	LM358D	-	-
Wafer Fab Site:	SH-BIP-1	Wafer Process:	BIPOLAR
Wafer Size Dia.(mm):	150	Protective Die Coating:	10KACN
信頼性試験計画			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size	
**Steady-state Life Test	150C, 300 Hrs	per spec	
Electrical Characterization	Full Temp Range	per spec	
ESD HBM	2000V	per spec	
ESD MM	50V	per spec	
ESD CDM	500V	per spec	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	
Ball Bond Shear	5 units, >76 balls, 0 fails	5	
Latch-up	per JESD78	6	
Manufacturability-(Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	
X-ray	top side only	5	
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC Level-1/260C			